

8 吋前段多晶矽與氧化層乾式蝕刻機 考核 check list

※使用前須注意事項

- 檢查使用記錄相關表單.....
- 機台狀況確認

※設備功能介紹

- 機台可蝕刻之材料.....★
- 晶圓種類的限制.....★
- 機台腔體名稱及用途.....★
- Recipe 中每步驟的意義.....★
- He 的用途及其流量值升高的意義.....★
- Endpoint 原理.....★
- Abort、Halt、EP 鈕如何使用.....
- 蝕刻時間限制.....★

※晶圓取放操作

- wafer 取放.....★
- cassette 取放.....★

※機台實際操作

- Recipe 下載之操作.....★
- 蝕刻參數修改操作.....★
- 製程執行操作.....★

※異常處理程序

- 簡易故障排除.....★
- 表單填寫(如異常處理單等).....
- 通報程序.....

※使用完畢

- 儀器使用完畢,確實填寫儀器使用紀錄簿.....

※ 其它

- 緊急狀況處理.....